

平成29年3月期
(第15期)
第2四半期決算説明会

平成28年11月10日
株式会社ジーダット

1. 平成29年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成29年3月期通期予想

平成29年3月期第2四半期決算のポイント

売上高 前年同期比：0.4%増

営業利益

前年同期比：11.6%増

経常利益

前年同期比：7.8%増

四半期純利益

前年同期比：41.2%増

海外市場向け売上高が大幅減少 前年同期比：66.6%減

国内市場向け売上高の増加により海外市場の減少分をカバー

設計者増員も諸費用削減の効果で固定費は微減

*平成27年6月30日付で連結子会社であった愛績旻（上海）信息科技有限公司の当社持分出資金の全部を譲渡したことにより今期より単体決算となっておりますが、本資料においては前期の連結業績との比較を行っております。

上半期実績

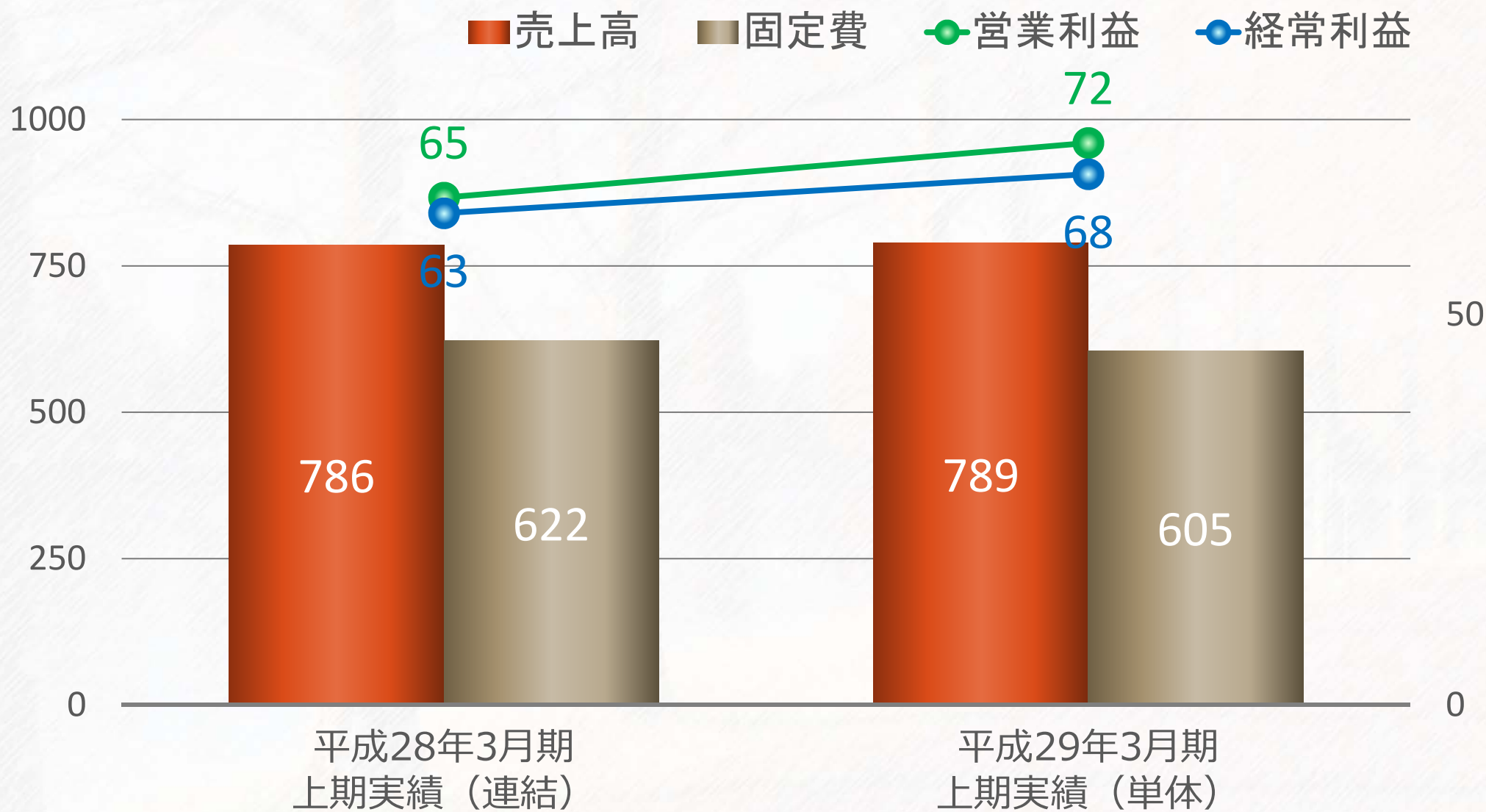
－ 前年同期比・計画比 －

(単位：百万円)	平成28年3月期 上半期実績 (連結)	平成29年3月期上半期 (単体)			
		当初計画	実績	前年 同期比	計画比
売上高	786	864	789	+0.4%	△8.6%
売上総利益 (率)	546 (69.6%)	584 (67.7%)	554 (70.2%)	+1.3%	△5.3%
販売費及び 一般管理費	481	514	481	△0.1%	△6.3%
営業利益	65	70	72	+11.6%	+2.6%
経常利益	63	70	68	+7.8%	△2.9%
四半期純利益	48	53	68	+41.2%	+27.7%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	34				

上半期売上高・利益

－ 前年同期比 －

(単位：百万円)



連結貸借対照表 - 前期末比 -

(単位：百万円)	平成28年 3月末 (連結)	平成28年 9月末 (単体)	差異		平成28年 3月末 (連結)	平成28年 9月末 (単体)	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,597	2,873	276	I 流動負債	330	558	228
1 現金及び預金	1,952	2,521	568	1 買掛金	27	20	△ 7
2 受取手形及び売掛金	212	199	△ 13	2 未払法人税等	8	15	7
3 電子記録債権	22	20	△ 1	3 賞与引当金	86	89	3
4 有価証券	300	-	△ 300	4 前受金	138	359	221
5 仕掛品	-	13	13	5 その他	70	73	2
6 原材料	3	6	2	負債合計	330	558	228
7 繰延税金資産	24	33	9	(純資産の部)			
8 その他	82	78	△ 3	I 株主資本	2,539	2,579	39
II 固定資産	273	265	△ 8	1 資本金	760	760	-
1 有形固定資産	17	15	△ 2	2 資本剰余金	890	890	-
2 無形固定資産	15	13	△ 2	3 利益剰余金	921	961	39
3 投資その他の資産合計	240	237	△ 3	4 自己株式	▲ 32	▲ 32	-
(1)投資有価証券	222	218	△ 3	III 新株予約権	1	1	-
(2)その他	18	18	0	純資産合計	2,540	2,580	39
資産合計	2,870	3,138	268	負債純資産合計	2,870	3,138	268

連結キャッシュフロー計算書

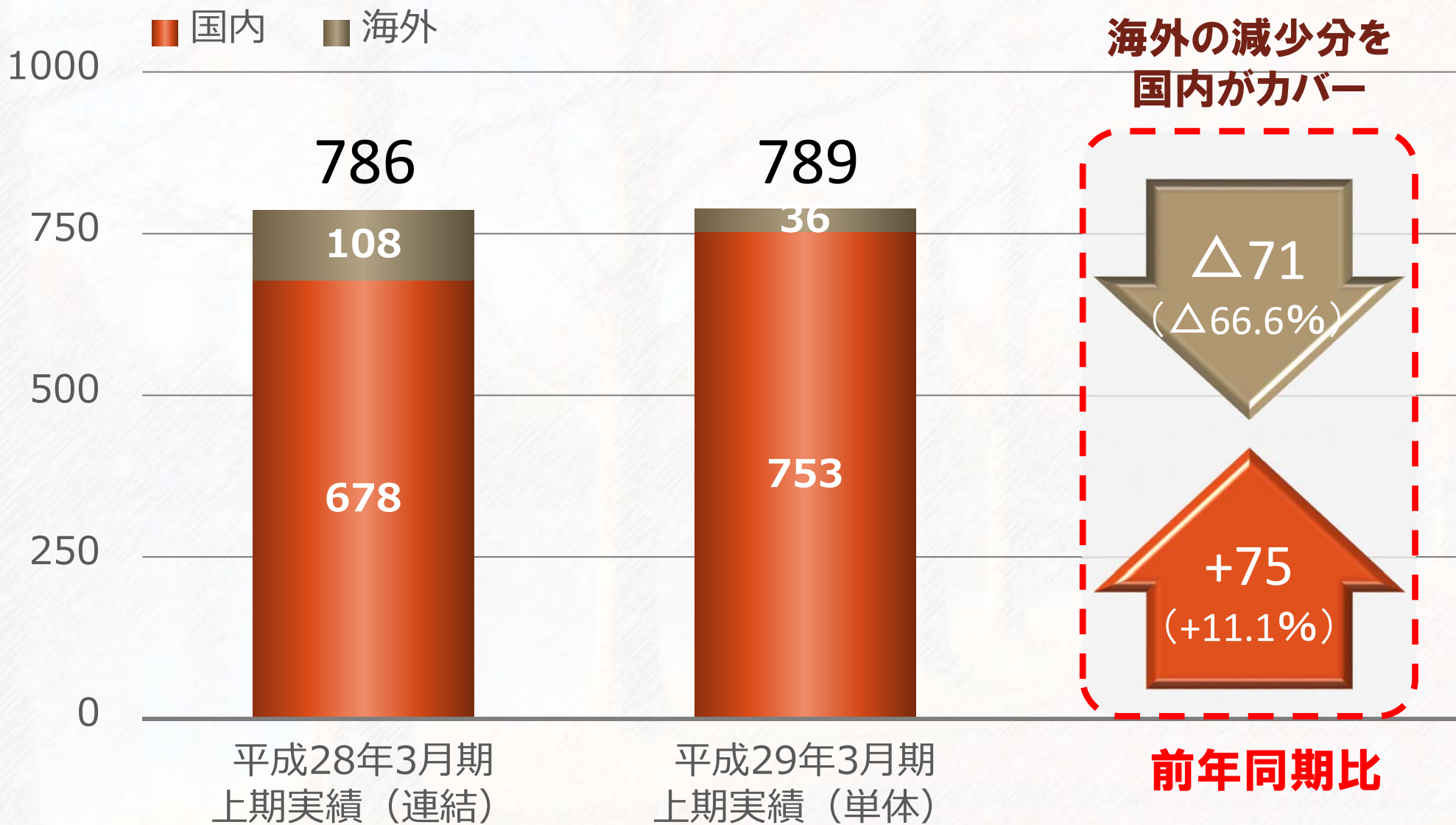
－前年同期比－

(単位：百万円)	平成27年4月1日 ～ 平成27年9月30日 (連結)	平成28年4月1日 ～ 平成28年9月30日 (単体)	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	195	前受金増加 305	110
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△66	有価証券償還 297	363
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△27	配当金 △28	△1
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△2	△6
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	105	571	466
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,018	1,024	5
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,123	1,595	571

地域別売上高（国内/海外）

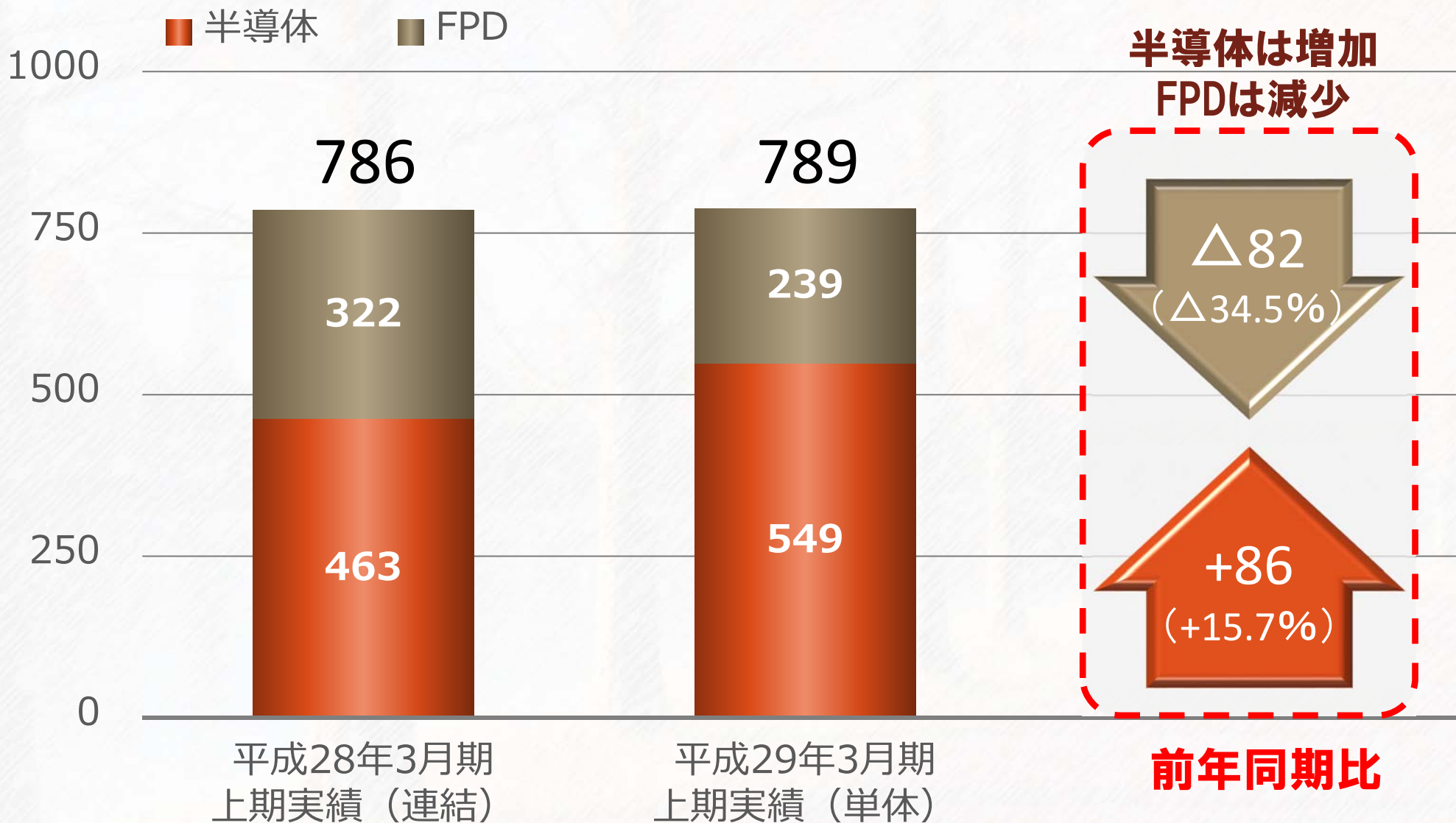
—前年同期比—

(単位：百万円)



市場別売上高 (半導体/FPD) -前年同期比-

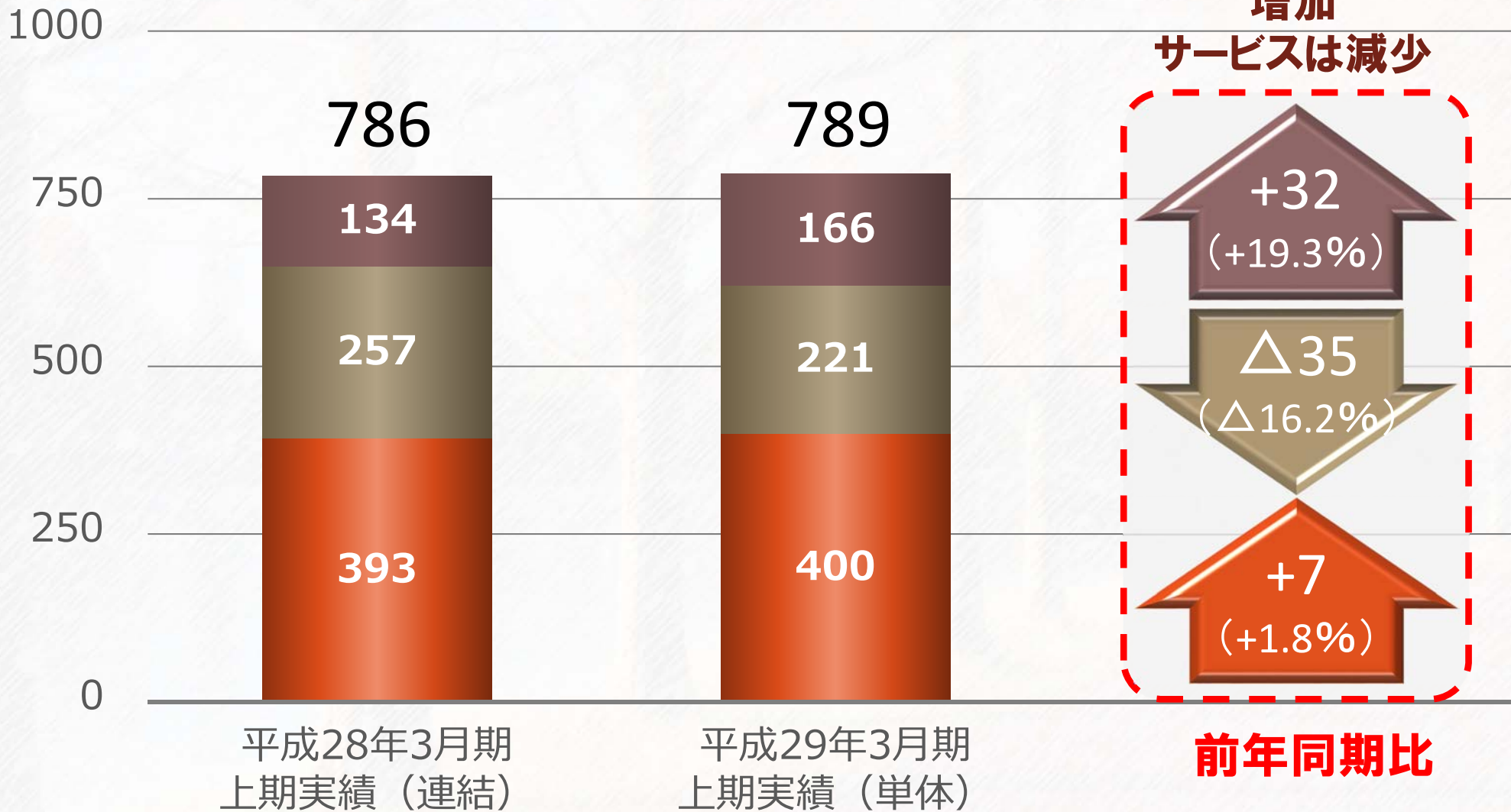
(単位：百万円)



事業別売上高 (製品/サービス/ソリューション) -前年同期比-

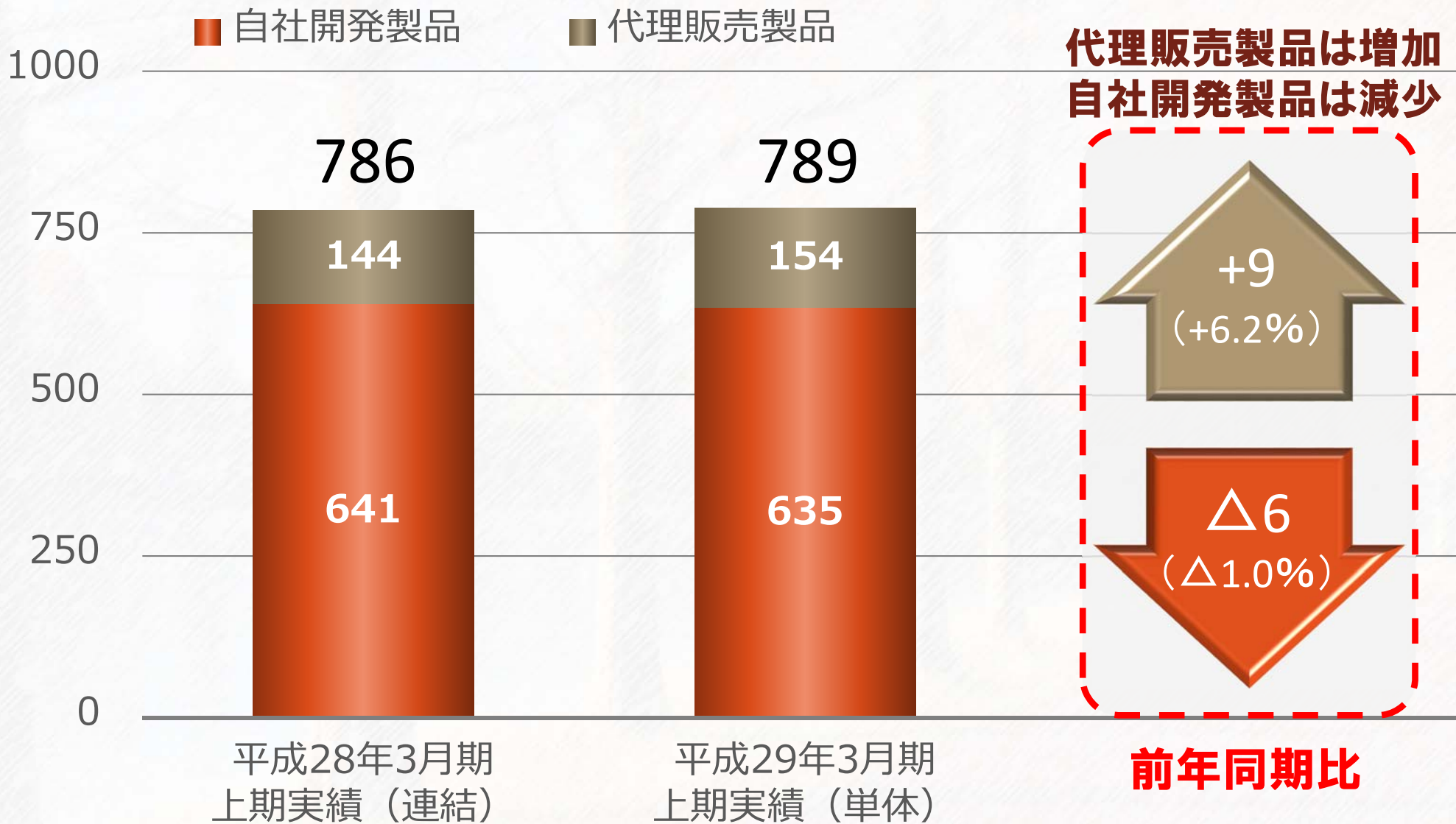
(単位：百万円)

■ 製品 ■ サービス ■ ソリューション



製品区分別売上高 (自社開発/代理販売) -前年同期比-

(単位：百万円)



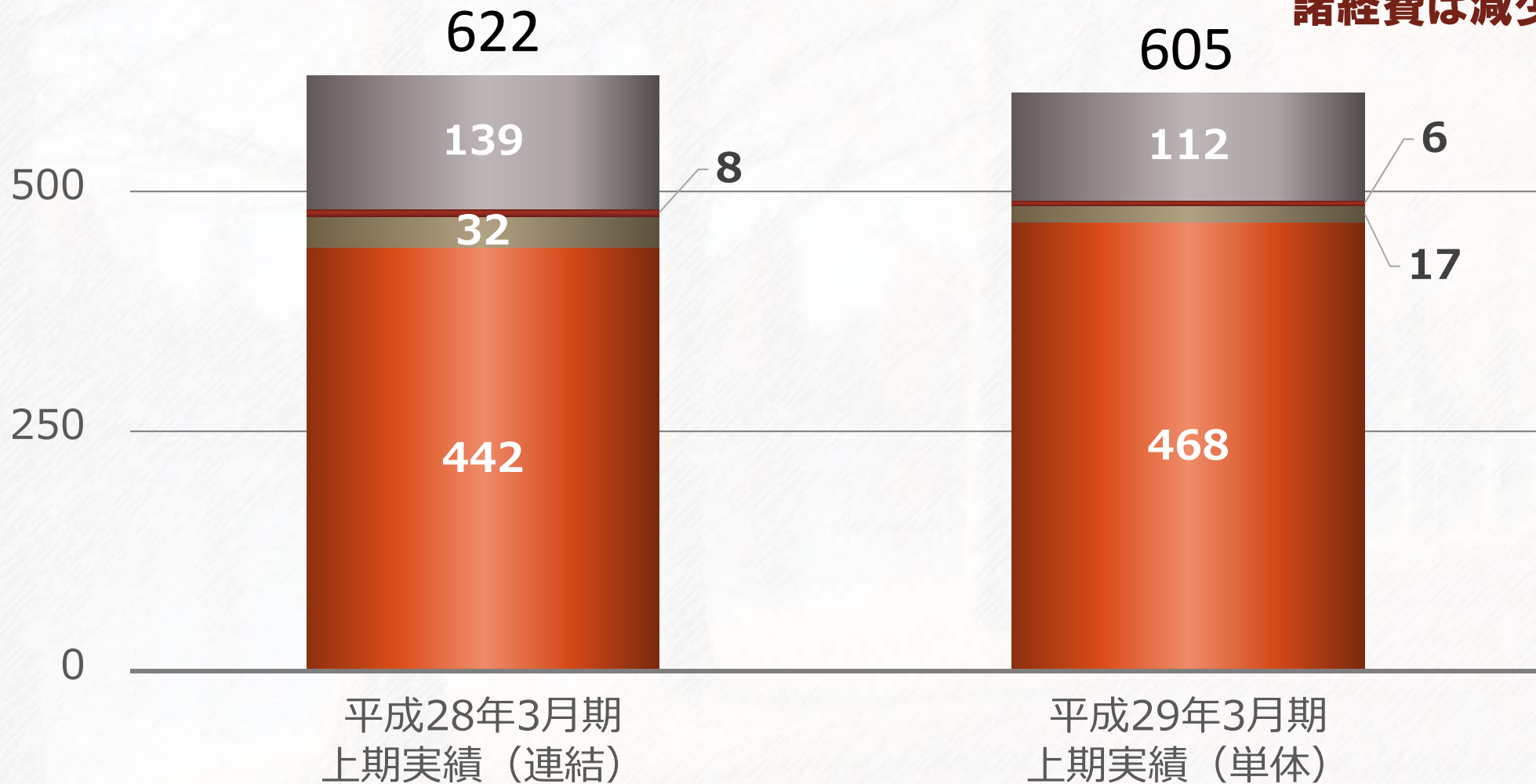
固定費内訳

－前年同期比－

(単位：百万円)

■ 人件費 ■ 外注費 ■ 減価償却費 ■ その他経費

**人件費は増加
諸経費は減少**



国内

- ◆円高・スマホ需要の減速により業績が減少傾向へ
- ◆一部メモリ・センサー関連は好調を維持
- ◆業界再編は途上のまま 一時終息・・・
- ◆半導体設計委託の需要は引き続き旺盛

海外

- ◆中国：景気減速も半導体・FPD事業には大規模投資を継続
- ◆台湾：大型LCDパネルが復調傾向
- ◆韓国：有機ELパネル開発に集中投資

- ◆ 次世代主力製品「SX-Meister」の開発に注力
 - ◆ Ver.1.0をリリース：次世代主力製品の基盤部分が完成
 - ◆ プライベートセミナーを開催：Ver.2.0以降の構想を発表
- ◆ ソリューション事業を拡張
 - ◆ 半導体設計者の更なる増員
 - ◆ EDAアウトソーシング事業の立ち上げ体制を増強
- ◆ 代理販売品を拡販
 - ◆ 回路解析系製品（ProPlus社製）の独占販売権を獲得
 - ◆ ライブラリ・IP検証製品の重点販売



1. 平成29年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成29年3月期 通期予想

◆ EDA開発事業

- ◆ 次世代主力製品「SX-Meister」の開発にリソースを傾注
 - ◆ “匠の技の継承”機能、設計自動化機能を優先開発
 - ◆ 自社半導体設計部隊との連携によりユーザ目線の開発を促進
- ◆ 電子部品系・素材系メーカーへの拡販活動
 - ◆ 解析系ツールの提案活動
 - ◆ 解析受託サービスの提案活動

◆ 代理販売事業

- ◆ 競争力のある解析・検証系製品を活用して活動範囲を拡張
 - ◆ 解析系ツール → メモリ関連へ
 - ◆ ライブラリ・IP作成検証系ツール → デジタル関連へ

◆ ソリューション事業

- ◆ EDAアウトソーシング事業の立ち上げを加速
 - ◆ 社内外のリソースを効率的に活用：トータルな提案・実施体制を確立
- ◆ 半導体受託設計サービスの更なる拡販
 - ◆ 半導体設計者を更に増員
 - ◆ ISO9001認証の獲得活動

◆ 海外向け事業

- ◆ 拡販に向けて代理店・顧客のサポートを拡充

◆ 新規ビジネスの模索

- ◆ ロケーション管理
- ◆ クリーンエネルギー検査・遠隔監視
- ◆ 見守り・ヘルスケア etc.

1. 平成29年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成29年3月期 通期予想

次世代主力製品の開発にリソースを傾注

半導体設計受託サービスの更なる拡販

EDAアウトソーシング事業の立ち上げを加速

通期予想 - 前年同期比 -

(単位:百万円)	平成28年3月期 実績(連結)	平成29年3月期(単体)	
		期初計画	前年同期比
売上高	1,586	1,750	+10.3%
営業利益	153	160	+4.0%
経常利益	153	160	+4.5%
当期純利益	112	126	+12.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	97		

ご清聴ありがとうございました